

说明

广东省重点研发计划项目“可敏捷定制的智能视觉处理器及系统应用”任务书中课题主要任务是“敏捷芯片设计、敏捷芯片工具链开发”，其中预算有 7.5 万元是用于“测试化验加工外协费”主要是用于新型敏捷神经网络加速器的片上系统（SoC）的芯片封装服务，与技术服务合同（乙方：深圳中电投资有限公司）中的技术服务内容一致。本次技术服务是对项目组设计的敏捷芯片处理器 72 颗裸片进行 BGA 外壳封装，芯片尺寸为 34mm x 34mm，共计 1053 根 Au 线，由于 Die 打线数量及信号输出数量要求较多，产品封装要求高，采用 6L 基板设计，以最小 layer 满足最大信号输出，因此定价为 61020 元，封装后的芯片将进一步用于 PCB 板级设计。

以上，

特此说明。

项目负责人：梁云

2023 年 2 月 9 日